

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年9月19日(2013.9.19)

【公開番号】特開2012-4322(P2012-4322A)

【公開日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-001

【出願番号】特願2010-137650(P2010-137650)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 3 1 1 T

【手続補正書】

【提出日】平成25年8月8日(2013.8.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

重ね合わされた複数の基板を加圧して貼り合わせる加圧ユニットを備え、

前記加圧ユニットは、

前記複数の基板が載置される載置部と、

前記載置部を介して前記複数の基板を加圧する加圧部と、

を有し、

前記複数の基板の外周部における前記加圧部の加圧力が、前記外周部より内側の領域における前記加圧部の加圧力よりも小さいことを特徴とする基板貼り合わせ装置。

【請求項2】

前記加圧部は、前記内側の領域に配置されている請求項1に記載の基板貼り合わせ装置。

。

【請求項3】

前記加圧部が前記載置部を加圧する領域は、前記複数の基板に素子が形成された素子形成領域内である請求項1または2に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項4】

前記載置部を介して前記複数の基板を加熱する加熱部を備え、

前記加圧部は、前記加熱部および前記載置部を介して前記複数の基板を加圧する請求項1から3のいずれか一項に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項5】

前記加熱部は、素子形成領域外まで配されている請求項4に記載の基板貼り合わせ装置。

。

【請求項6】

前記加熱部は、前記複数の基板の外側まで配されている請求項5に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項7】

前記加熱部は、前記載置部よりも外側まで配されている請求項5または6に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項8】

前記載置部の外縁は、前記複数の基板の外縁またはその外側に位置する請求項7に記載

の基板貼り合わせ装置。

【請求項 9】

前記加圧ユニットは、前記加熱部に当接して配され、前記複数の基板を冷却する冷却部をさらに有し、

前記冷却部は、前記複数の基板の外縁またはその外側まで配される請求項 8 に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項 10】

前記加圧ユニットと、

前記加圧ユニットに向かい合った他の加圧ユニットとを備え、

前記加圧ユニットと前記他の加圧ユニットとの間で前記複数の基板を加圧する請求項 1 から 9 のいずれか一項に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項 11】

請求項 1 から 10 のいずれか一項に記載の基板貼り合せ装置により基板を貼り合せることを含む積層半導体装置製造方法。

【請求項 12】

請求項 1 1 に記載の積層半導体装置製造方法により製造された積層半導体装置。